



CAS IR Grid / 微电子研究所 / 中国科学院微电子研究所 / 系统封装与集成研发中心

基于TSV的2.5D/3D封装制造及系统集成技术

文献类型: 成果

热门

作者 曹立强¹; 张文奇; 李君¹; 戴风伟¹; 孙鹏

获奖日期 2017

文献子类 中国电子学会科学技术奖技术发明类

奖励等级 二等奖

语种 中文

源URL [http://159.226.55.106/handle/172511/18487]

专题 微电子研究所_系统封装与集成研发中心

作者单位 中国科学院微电子研究所

推荐引用方式 曹立强,张文奇,李君,等. 基于TSV的2.5D/3D封装制造及系统集成技术. . 2017.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [微电子研究所](#)

浏览	下载	收藏
1787	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。